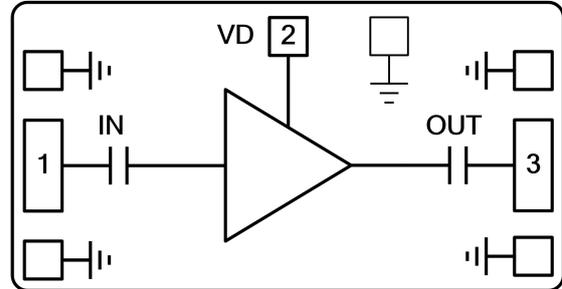




### 主要特点

- 工作频率: 0.5- 4 GHz
- 增益: 21 dB
- 噪声系数: 5 dB
- 直流供电: +5 V @ 35 mA
- 反向隔离: 24 dB
- P1dB: +14 dBm
- 芯片尺寸: 1.5×1.0× 0.1 mm<sup>3</sup>

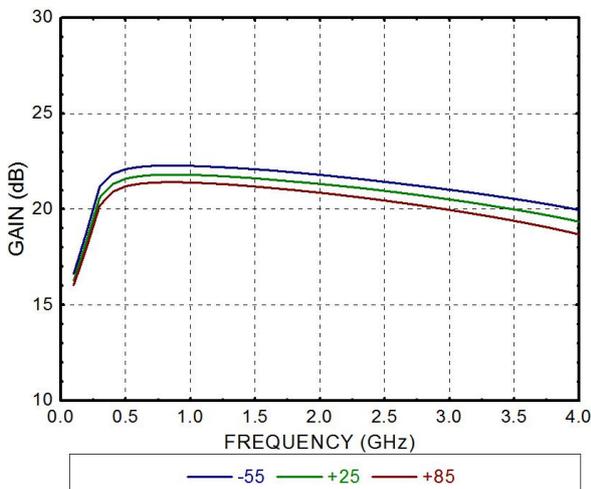
### 功能框图



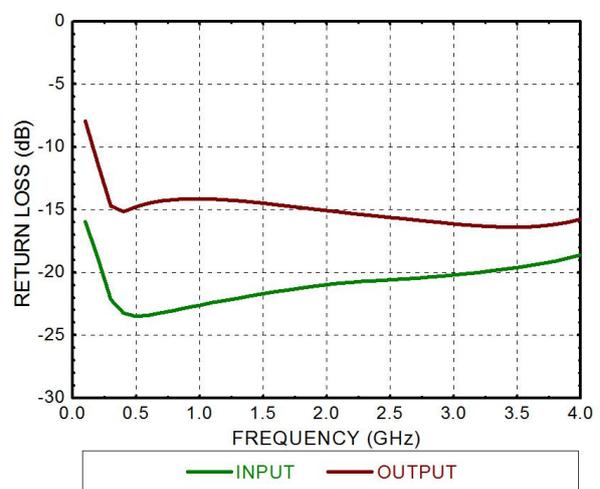
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $V_{DD} = +5\text{ V}$ , $I_{DD} = 35\text{ mA}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	0.5 - 4			GHz
增益		21		dB
输入回波损耗		20		dB
输出回波损耗		15		dB
反向隔离度		24		dB
输出功率 1dB 压缩点		14		dBm
噪声系数		5		dB
OIP3		24		dBm
工作电流	25	35	45	mA

### 增益 vs. 温度

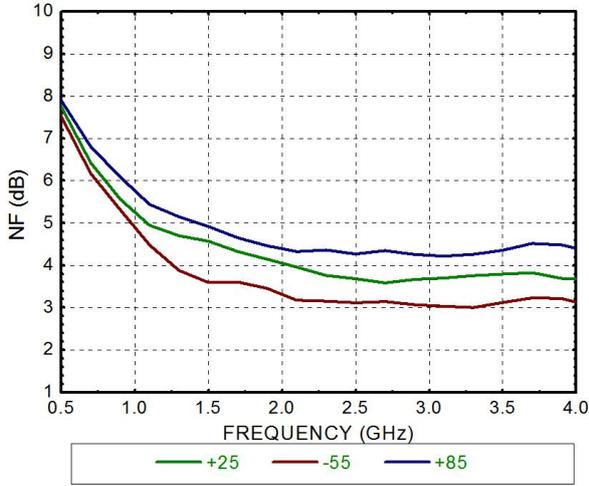


### 回波损耗

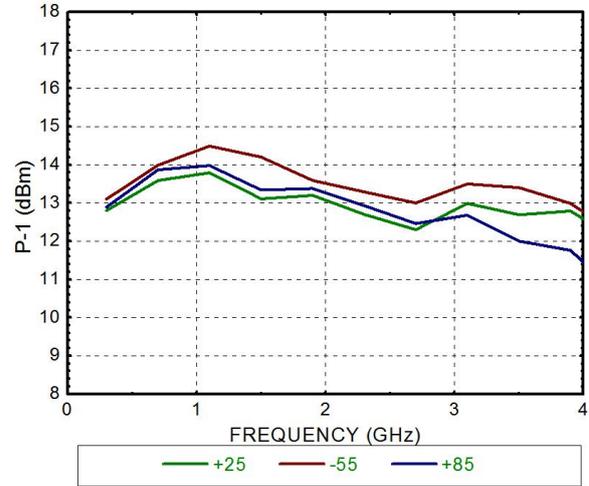




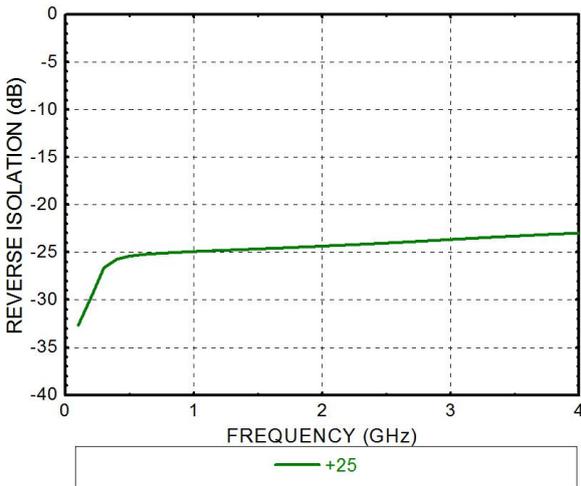
### 噪声vs. 温度



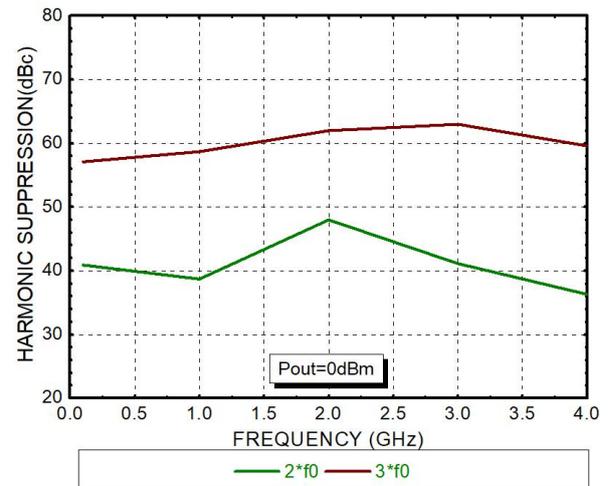
### 输出功率P1dBvs. 温度



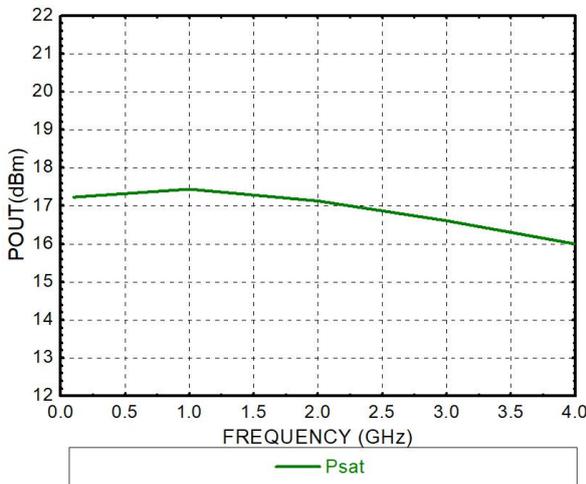
### 反向隔离



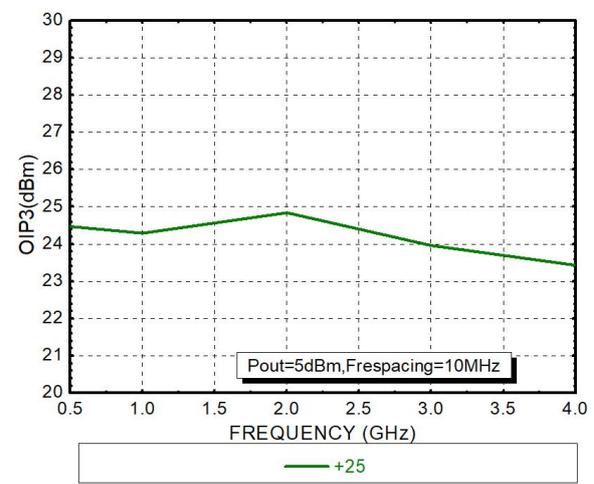
### 谐波抑制



### 输出饱和功率



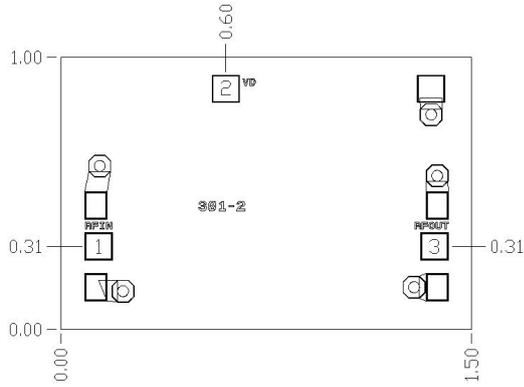
### OIP3





### 物理参数

单位: mm



### 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘提供放大器的电源电压, 需要外接 1000 pF 和 0.01 μF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合, 片上集成了隔直电容, 匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

### 极限参数

射频输入功率: +17dBm

储存温度: -65~+150°C

输出端口供电: +8V

工作温度: -55~+85°C